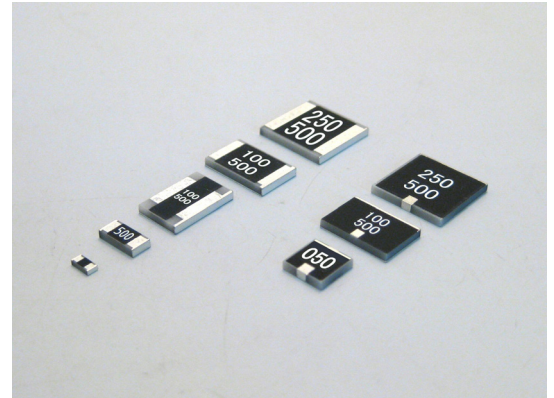


高周波用表面実装ターミネーション
SURFACE MOUNT
HIGH POWER TERMINATIONS

RFTS, RFTSA, RFTSB



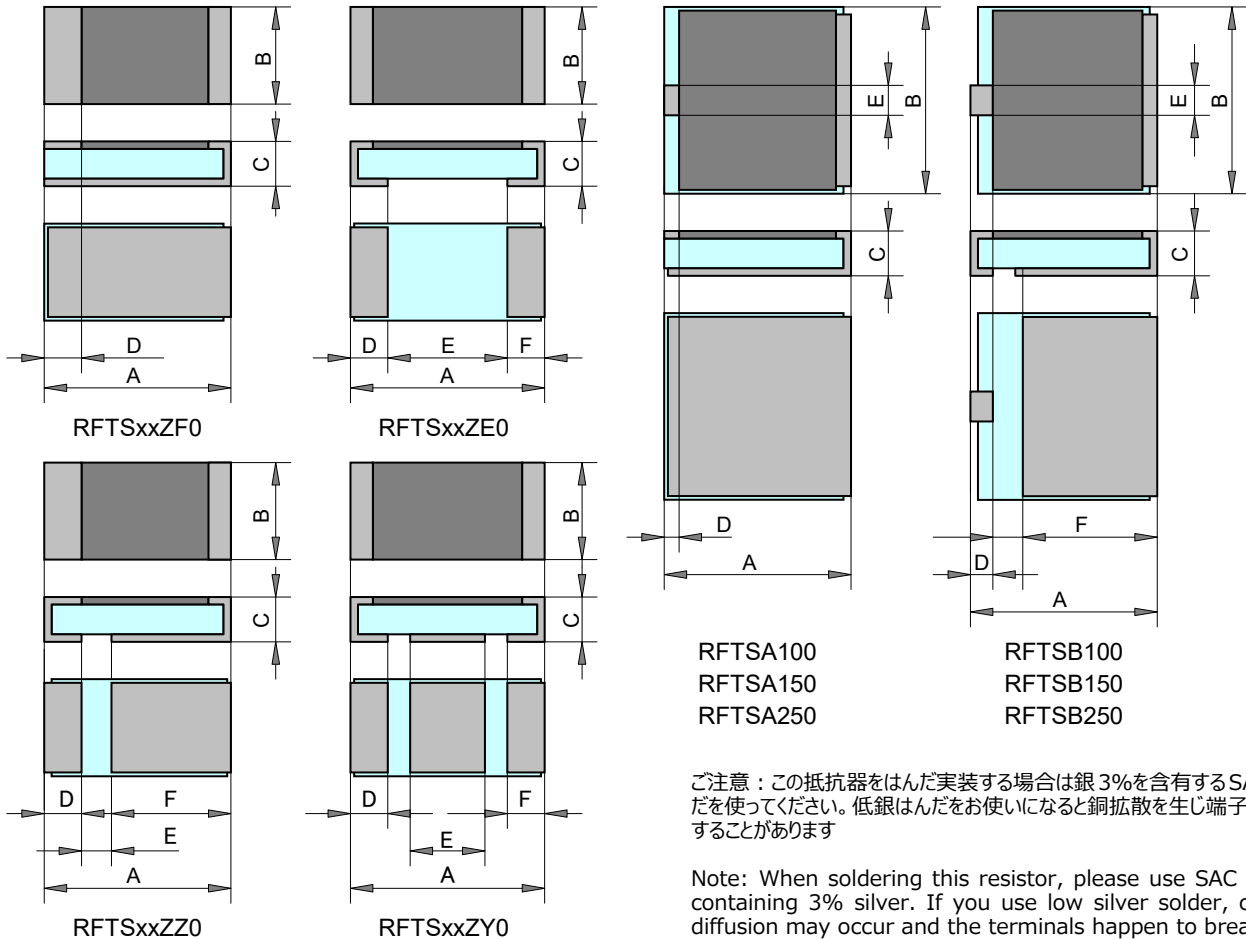
特長用途

DC-6GHz 帯までの高電力表面実装ターミネーション。
熱伝導の高いALNセラミック基板を使用し小型で広帯域の製品を提供。ターミネーションの発熱をチップの裏面からあるいは端子から配線板の銀板、銅板に放熱する構造。
基板への金属膜の成膜はスパッタ工程で、はんだ付けによる着膜強度の劣化がきわめて少ない材料構成。
インピーダンスは 50Ω を許容差 1%にて標準化。
定格電力は 5W から 250W。
移動体固定局通信機、広帯域高周波電力増幅器のアイソレータ終端、その他のターミネーション。

Features and Applications

High power surface mount terminations for DC up to 6GHz applications.
Small size and wide frequency range specifications realized with large heat conducting ALN substrate.
Sufficient mechanical strength metallization from sputtered thin film technology.
50ohm characteristic impedance with tolerance 1% in dc and 5W to 250W provided as standard, and other resistance and power available.
Long life and temperature stability a result of Ni-Cr thin film technology.
Terminations for isolator/circulators, fixed station of mobile communication electronics, and high power microwave amplifiers.

外観寸法 Style and Dimension



高周波用表面実装ターミネーション

SURFACE MOUNT HIGH POWER TERMINATIONS RFTS, RFTSA, RFTSB

寸法 Dimensions (mm)

Rated Power (W)	Type	Terminal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
5	RFTS05	ZF0	2.54	1.27	0.63	0.70+/-0.2	-	-
5	RFTS05	ZE0	2.54	1.27	0.63	0.70+/-0.2	(1.14)	0.70+/-0.2
10	RFTS10	ZF0	5.08	2.54	1.00	1.00	-	-
10	RFTS10	ZE0	5.08	2.54	1.00	1.00	3.00	1.00
50	RFTS50	ZF0	5.08	5.08	1.20	1.00	-	-
50	RFTS50	ZE0	5.08	5.08	1.20	1.00	3.00	1.00
50	RFTS50	ZZ0	5.08	5.08	1.20	3.00	1.08	1.00
50	RFTS50	ZY0	5.08	5.08	1.20	1.00	2.00	1.00
100	RFTS100	ZF0	5.84	8.89	1.20	1.20	-	-
100	RFTS100	ZE0	5.84	8.89	1.20	1.20	2.40	1.20
100	RFTS100	ZZ0	5.84	8.89	1.20	3.40	1.20	1.20
100	RFTS100	ZY0	5.84	8.89	1.20	1.20	2.40	1.20
100	RFTSA100	---	5.84	8.89	1.20	1.20	1.20	---
100	RFTSB100	---	5.84	8.89	1.20	1.20	1.20	1.20
150	RFTSA150	---	8.89	8.89	1.20	1.20	1.20	---
150	RFTSB150	---	8.89	8.89	1.20	1.20	1.20	1.20
250	RFTSA250	---	9.52	9.52	1.20	1.20	1.20	---
250	RFTSB250	---	9.52	9.52	1.20	1.20	1.20	1.20

形名呼称 Ordering Information

Type	TCR	Impedance	Tolerance	Terminals & T/R	Note
RFTS50	C	500	F	ZF0	---
RFTS05	C (50ppm/K)	500 (50ohm)	F (1%)	ZF0	Bulk
RFTS10				ZE0	Bulk
RFTS50				ZZ0	Bulk
RFTS100				ZY0	Bulk
				ZF1	Tape reel
				ZE1	Tape reel
				ZZ1	Tape reel
				ZY1	Tape reel
RFTSA100	C	500	F	Z00	---
RFTSA100	C (50ppm/K)	500 (50ohm)	F (1%)	Z00	Bulk
RFTSB100				Z01	Tape reel
RFTSA150					
RFTSB150					
RFTSA250					
RFTSB250					

性能 Specifications and Performances

Type	RFTS 05	RFTS 10	RFTS 50	RFTS 100	RFTS 150	RFTS 250	Conditions
Rated Power (W)	5	30	50	100	150	250	
Maximum Power (W)	10	60	100	200	300	500	Pulse<1 second
Impedance (Ohms)	50 Ohms						
TCR (ppm/C)	50						
Tolerance (%)	1.0						
Heat Resistance (C/W)	12.5	6.5	2.5	1.3	1.0	0.5	
VSWR at 1GHz	1.15	1.15	1.2	1.2	1.2	1.2	
Max Operating Temperature	-55 - 155 deg C						
Storage Temperature	-55 - 155 deg C						

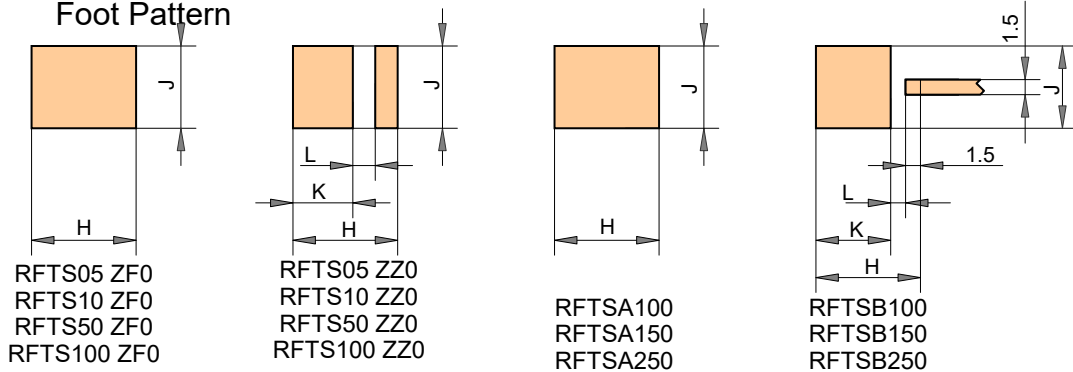
高周波用表面実装ターミネーション

SURFACE MOUNT HIGH POWER TERMINATIONS

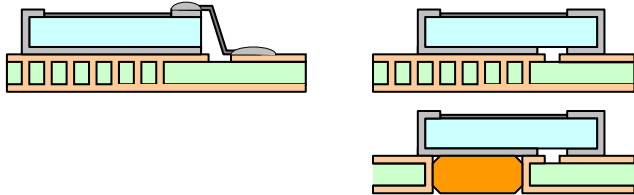
RFTS, RFTSA, RFTSB

実装寸法

Foot Pattern



実装方法 Installation



(mm)	H	J	K	L
RFTS05 ZF0	2.94	1.50	-	-
RFTS05 ZZ0	2.94	1.50	-	-
RFTS10 ZF0	5.48	2.94	-	-
RFTS10 ZZ0	5.48	2.94	(2.98)	0.5
RFTS50 ZF0	5.48	5.48	-	-
RFTS50 ZZ0	5.48	5.48	(2.98)	0.5
RFTS100 ZF0	6.24	9.29	-	-
RFTS100 ZZ0	6.24	9.29	(3.24)	0.5
RFTS150 010	6.75	9.92	--	---
RFTS150 020	6.75	9.92	(4.48)	0.5
RFTS250 010	9.92	9.92	--	-
RFTS250 020	9.92	9.92	(6.92)	0.5

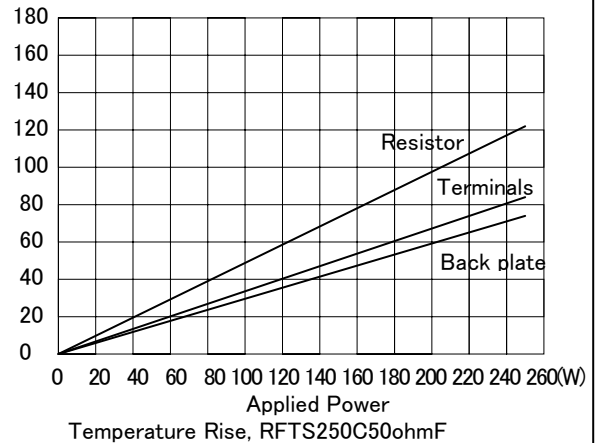
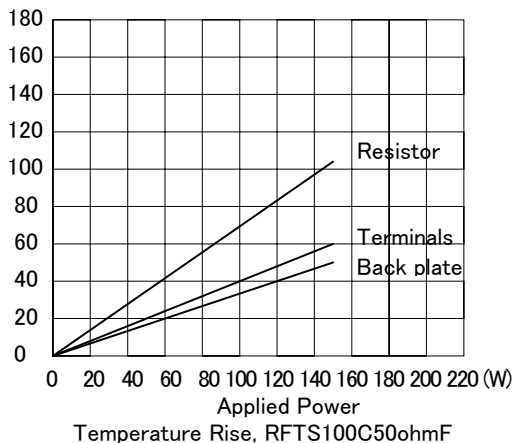
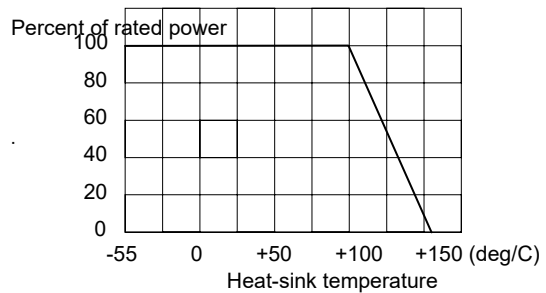
注記

- (1) 端子、裏の放熱導体を 90µm銅箔プリント基板にはんだ付けし、銅箔の熱を効率的に外部に引き出したときの銅箔温度で定格電力を定義しています。
- (2) RFTS の放熱導体をプリント基板にはんだ付けする際の仕上がりはんだ厚みは 50µm以下に抑えてください。
- (3) ターミネーション背面に円柱銅チップを勘合させて埋め込み、放熱する方法を推奨する。

Remarks

- (1) Power rating assumes that chip attached on metal insulated PC board.
- (2) Solder joint design should assure a solder thickness within 50 micron meters.
- (3) Cu inlet inserted in to circuit board will help effective heat conduction.

負荷軽減曲線 Derating Curve



高周波用表面実装ターミネーション

SURFACE MOUNT HIGH POWER TERMINATIONS RFTS, RFTSA, RFTSB

